



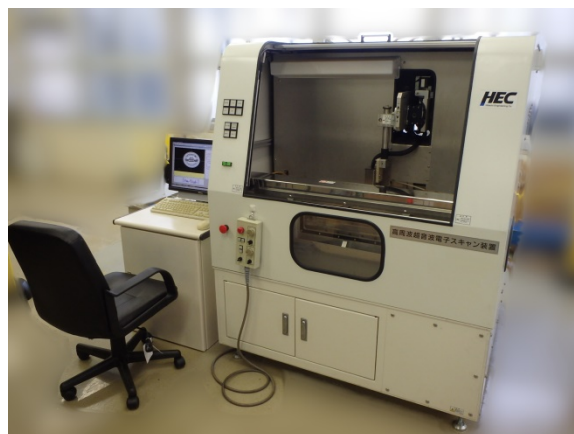
高速電子スキャン方式高周波超音波画像化装置による 非破壊検査、計測サービス

高周波超音波を用いて内部を非破壊で画像化し、欠陥の検出などを行います。

概要

高速電子スキャン方式高周波超音波画像化装置は、超音波を用いて金属、樹脂、セラミックなどの内部欠陥(ポイド、クラック、介在物、接着面の剥離など)の検出や、表面または内部構造の画像化を行う装置です。一般的な超音波画像化装置よりも高周波の超音波プローブと高精度水浸スキャナを用いることで数十 μm レベルの内部欠陥を検出し、平面図や断面図などの情報を得ることができます。アレイ型プローブを採用することにより、超音波ビームの角度や集束点を任意に変更することができ、測定対象に最適な設定を行うことができます。大量検査から研究・開発まで、お客様の幅広いニーズにお応えいたします。

- ・メーカー： 日立エンジニアリング
- ・走査範囲： 300×200mm
- ・測定分解能： 20 μm
(最小走査ピッチ)
- ・プローブ： 50MHz(リニアアレイ方式)
- ・アレイ制御： 最大384ch(同時励起数最大32ch)
- ・深度分解能： 12 μm (鋼の場合)
- ・観察方法： 試験片を装置水槽内に水没させて観察します。

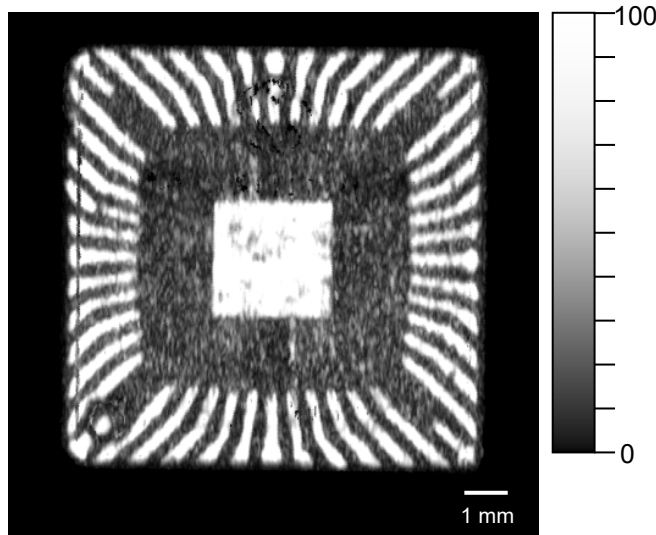


高速電子スキャン方式高周波超音波画像化装置

測定事例



(a)外観



(b)超音波画像

ICチップの内部構造の画像化



JFE テクノリサーチ 株式会社

<https://www.jfe-tec.co.jp>

☎ 0120-643-777

Copyright ©2020 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.
本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。